

Preliminary Amendment

Applicant: Michael Bauer et al.

Serial No.: Unknown

(Priority Application No. 10 2004 025 279.3)

(International Application No. PCT/DE2005/000892)

Filed: Herewith

(Priority Date: 19 May 2004)

(International Filing Date: 17 May 2005)

Docket No. I431.145.101/FIN 606 PCT

**Title: SUPPORT WITH SOLDER BALL ELEMENTS AND A METHOD FOR
POPULATING SUBSTRATES WITH SOLDER BALLS**

IN THE CLAIMS

Please cancel claims 2-18 without prejudice.

1. Träger mit Lotkugelementen (1) für ein Bestücken von Substraten (2) mit Kugelkontakte (3), wobei der Träger (4) folgende Merkmale aufweist:
eine einseitig aufgebrachte Klebstoffsicht (5), wobei die Klebstoffsicht (5) winen Thermoplast oder Duroplast aufweist, dessen Adhäsion skraft bei Bestrahlung vermindert ist;
Lotkugelemente (1), die dichtgepackt in Zeilen (6) und Spalten (7) auf der Klebstoffsicht (5) in vorgegebener minimalzulassiger Schrittweite (w) fur einen Halbleiterchip (8) oder rein Halbleiterbauteil (9) angeordnet sind.

2-18. (Cancelled)